

浙江晶盛机电股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	141,602.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	53,783.41
	利息收入净额	B2	6,587.19
	理财产品投资收益	B3	1,013.26

项 目		序号	金 额
	自有资金支付的发行费用	B4	1.89
本期发生额	项目投入	C1	137.36
	利息收入净额	C2	27.36
	理财产品投资收益	C3	317.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	53,920.77
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,614.55
	理财产品投资收益	D3=B3+C3	1,331.14
	自有资金支付的发行费用	D4=B4	1.89
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3+D4	95,629.51
实际结余募集资金		F=F1+F2+F3	95,629.51
其中：存放于募集资金存款专户		F1	45,629.51
购买理财产品余额		F2	0.00
暂时性补充流动资金		F3	50,000.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行	201000311819397	282,151,701.29	募集资金专户
	201000311606374	143,431.58	募集资金专户
中国银行股份有限公司上虞支行	372781380499	173,999,972.23	募集资金专户
杭州银行股份有限公司北山支行	3301041060003140104	0.00	募集资金现金管理专用结算账户
合计		456,295,105.10	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见附件 1。
- 2、本期无超额募集资金的使用情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”无法单独核算效益。该募投项目作为公司研发体系的一部分，在项目实施后，能够完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，提升公司的研发和测试能力，推动公司设备工艺改进，助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程。公司对该项目不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。

（四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行发行的保本

型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2025年4月18日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2026年4月9日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

（五）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024年8月21日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025年8月14日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 40,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2025年8月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 50,000.00 万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目的审议决策情况

公司 2026 年 6 月 3 日召开第六届董事会第五次会议、2026 年 6 月 22 日召

开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况将“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的募集资金投资总额调整为 17,800.00 万元，并将该项目剩余募集资金及已终止的“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计 86,141.00 万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）改变募集资金投资项目的说明

1、终止年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目原因

因项目所需进口设备采购周期长，不能满足公司快速响应市场的业务发展需求，为紧抓行业发展机遇，快速抢占市场，公司转变为在供应市场直接采购相关零部件；另外，公司不断提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，已能够逐步满足公司抛光减薄设备核心零部件需求。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，公司决定不再增加该项目后续的零部件加工设备投入。

2、减少 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目投资金额原因

因项目在实施建设过程中，国内半导体产业链逐步完善，国产半导体装备零部件性能持续提升，公司设备供应链逐步实现国产化，伴随着规模的提升，相关设备制造成本较之前有所下降，公司出于节省成本考虑，将投入建设的自产设备以成本结转，相较项目规划时的市场价格大幅降低。另外，随着国产检测设备性能持续提升，在满足项目建设技术需求的前提下，公司计划将部分进口的检测设备改为采购国产设备，将进一步节省项目的设备投入成本。

3、新增半导体装备精密零部件智能化生产项目原因

当前，我国在半导体高端设备领域面临挑战，其中关键零部件的“卡脖子”问题较为突出，本项目的实施将着力突破精密零部件的国产化，满足日益高涨的市场需求，大幅缩短交付周期、降低综合成本，显著提升国产高端零部件的自主保障能力，对保障国家信息产业安全、提升国际竞争力具有深远影响。

4、新增高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目原因

本项目的实施，一方面顺应了国家半导体的发展趋势，可实现国产技术、产品的突破，满足市场日益增长的需求。另一方面符合公司“新材料、新装备”战略

定位，同时完善公司在高端装备产业链中对半导体级碳化硅精密零部件特殊要求的配套能力，实现零部件及产品的全流程自主化生产，进一步提高公司在半导体领域的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：改变募集资金投资项目情况表

浙江晶盛机电股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

附件 1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			141,602.70		本报告期投入募集资金总额		137.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			38,570.00		已累计投入募集资金总额		53,920.77			
累计变更用途的募集资金总额			78,823.54							
累计变更用途的募集资金总额比例			55.67%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目	是	56,370.00	17,800.00	137.36	8,734.50	49.07	2027 年 6 月 30 日	-	-	否
年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目	是	43,210.00	2,956.46		2,956.46	100.00	终止	-	-	否
半导体装备精密零部件智能化生产项目	是		66,131.00				2028 年 6 月 30 日	-	-	否
高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目	是		20,010.00				2028 年 6 月 30 日	-	-	否
补充流动资金	否	42,420.00	42,022.70		42,229.81	100.49	-	-	-	-
合 计	-	142,000.00	148,920.16	137.36	53,920.77	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 50,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 95,629.51 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户金额为 45,629.51 万元，暂时补充流动资金金额为 50,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的 原承诺项目	改变后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
半导体装备精密 零部件智能化生 产项目	年产 80 台套半导 体材料抛光及减薄 设备生产制造项 目、12 英寸集成电 路大硅片设备测试 实验线项目	66,131.00	-	-	-	-	-	-	否
高端半导体设备 碳化硅零部件产 业化项目	年产 80 台套半导 体材料抛光及减薄 设备生产制造项目	20,010.00	-	-	-	-	-	-	否
合 计	—	86,141.00	-	-	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1. 减少 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目投资金额原因 因项目在实施建设过程中，国内半导体产业链逐步完善，国产半导体装备零部件性能持续提升，公司设备供应链逐步实现国产化，伴随着规模的提升，相关设备制造成本较之前有所下降，公司出于节省成本考虑，将投入建设的自产设备以成本结转，相较项目规划时的市场价格大幅降低。另外，随着国产检测设备性能持续提升，在满足项目建设技术需求的前提下，公司计划将部分进口的检测设备改为采购国产设备，将进一步节省项目的设备投入成本。 2. 终止年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目原因						

	因项目所需进口设备采购周期长，不能满足公司快速响应市场的业务发展需求，为紧抓行业发展机遇，快速抢占市场，公司转变为在供应市场直接采购相关零部件；另外，公司不断提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，已能够逐步满足公司抛光减薄设备核心零部件需求。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，公司决定不再增加该项目后续的零部件加工设备投入。 3. 新增半导体装备精密零部件智能化生产项目原因 当前，我国在半导体高端设备领域面临挑战，其中关键零部件的“卡脖子”问题较为突出，本项目的实施将着力突破精密零部件的国产化，满足日益高涨的市场需求，大幅缩短交付周期、降低综合成本，显著提升国产高端零部件的自主保障能力，对保障国家信息产业安全、提升国际竞争力具有深远影响。 4. 新增高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目原因 本项目的实施，一方面顺应了国家半导体的发展趋势，可实现国产技术、产品的突破，满足市场日益增长的需求。另一方面符合公司“新材料、新装备”战略定位，同时完善公司在高端装备产业链中对半导体级碳化硅精密零部件特殊要求的配套能力，实现零部件及产品的全流程自主化生产，进一步提高公司在半导体领域的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。 5. 决策程序及信息披露情况说明 2026年6月3日公司召开第六届董事会第五次会议、2026年6月22日公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的募集资金投资总额调整为17,800.00万元，并将该项目剩余募集资金及已终止的“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用